

全自动晶圆缺陷检测系统

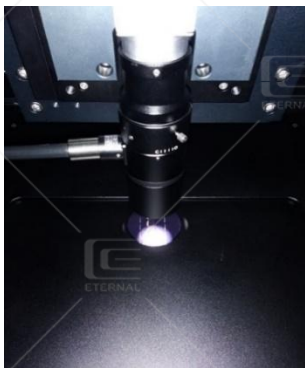


产品特点

- 支持全自动上下料模块（可选）
- 自动识别晶圆编码，并生成对应检测报告
- 对缺陷芯片InK标记（可选），便于下道工序筛选
- 自定义缺陷检测内容和区域
- 软件架构平台化：功能模块化，方便新增不同类型晶圆检测
- 检测参数可调：每个区域自定义缺陷尺寸大小、对异色容忍度等关键参数
- 硬件系统定制化：可根据用户对检测精度、检测时间要求，适配相应的硬件模块

产品应用

可检测脏点、划痕、异色、异物残留、尺寸误差等缺陷，适用于CMOS、半导体晶圆以及其他机器视觉相关领域。



固定倍率检测



可变倍率检测

系统规格

最小缺陷	0.5 μ m
晶圆尺寸	2"/6"/8"/12"
单次最多检测	50pcs

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

